

- (iii) that have X and Y positioning speeds above 0.125 m/s for drilling or routing; and
- (g) stored program controlled cyclic voltametric stripping equipment specially designed for printed circuit board plating, bath monitoring and analysis.

Equipment for the Manufacture or Testing of Electronic Components and Materials

- 1355** (1) In this item, “assembly” means a grouping of components such as circuit elements, discrete components or microcircuits that are connected together to perform a specific function or functions and that as an entity is replaceable and capable of being disassembled; (*ensemble*)
- “magnetically enhanced”, in respect of equipment, means equipment that incorporates a cathode assembly having an integral magnetic structure for enhancing plasma intensity; (*améliorée par concentration magnétique*)
- “masks” includes masks used in electron beam lithography, X-ray lithography, ultraviolet lithography, ultraviolet photolithography and visible photolithography; (*masques*)
- “stored program controlled” has the same meaning as in item 1354. (*à commande par programme enregistré*)

(2) Subparagraph (3)(b)(vii)(B) does not include test equipment that is not of a general purpose nature and that is specially designed for and dedicated to

- (a) testing assemblies or a class of assemblies for home and entertainment applications; or
- (b) testing electronic components, assemblies and integrated circuits expressly excluded by item 1564, provided that the test equipment does not incorporate computing facility with user-accessible programming capability.

(3) Equipment for the manufacture or testing of electronic components and materials and specially designed components, accessories and software therefor, as follows:

- (a) equipment specially designed for the manufacture or testing of electron tubes and optical elements, and specially designed components therefor, included in item 1541, 1542, 1555, 1556, 1558 or 1559; and
- (b) equipment specially designed for the manufacture or testing of semiconductor devices, integrated circuits and assemblies and systems that have the characteristics of that equipment, as follows:
 - (i) equipment, other than quartz crucibles for the processing of materials for the manufacture of semiconductor devices, integrated circuits and assemblies, as follows:
 - (A) equipment for producing polycrystalline silicon included in paragraph 1757(f) having a purity of 99.99 per cent or more in the form of rods, ingots, boules, pellets, sheets, tubes or small particles.
 - (B) equipment specially designed for purifying or processing the III-V and II-VI semiconductor materials included in item 1757,
 - (C) crystal pullers, furnaces and gas systems that are
 - (I) those with specially designed stored program controlled temperature, power input or gas, liquid or vapour flow,

- (iii) vitesses de positionnement X et Y supérieures à 0,125 m/s pour les forets ou pour les pointeaux;
- g) équipement de rectification cyclique voltamétrique à commande par programme enregistré spécialement conçu pour le contrôle et l'analyse du bain de galvanoplastie des plaques de circuits imprimés.

Équipement pour la fabrication ou l'essai de composants et de matériaux électroniques

- 1355** (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- «amélioré par concentration magnétique» S'entend de l'équipement contenant un ensemble cathode ayant une structure magnétique intégrée pour augmenter l'intensité du plasma. (*magnetically enhanced*)
- «à commande par programme enregistré» S'entend au sens de l'article 1354. (*stored program controlled*)
- «ensemble» Groupe de composants, à savoir éléments de circuits, composants discrets ou microcircuits reliés ensemble pour accomplir une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui sont globalement remplaçables et qui peuvent être séparables. (*assembly*)
- «masques» S'entend notamment des masques utilisés en lithographie à faisceau électronique, lithographie à rayons X, lithographie aux ultra-violets et photolithographie normale utilisant les ultra-violets et le spectre visible. (*masks*)

(2) La division (3)(b)(vii)(B) n'inclut pas l'équipement d'essai qui n'est pas universel et qui est spécialement conçu pour l'un ou l'autre des essais suivants et est consacré à:

- a) l'essai d'ensembles ou de catégories d'ensembles pour applications domestiques ou destinées au grand public;
- b) l'essai de composants électroniques, d'ensembles ou de circuits intégrés expressément exclus aux termes de l'article 1564, à condition que cet équipement d'essai ne comprenne pas de dispositif de calcul offrant une programmabilité accessible à l'utilisateur.

(3) Équipement pour la fabrication ou l'essai de composants et de matériaux électroniques ainsi que ses composants, accessoires et logiciel spécialement conçus, à savoir:

- a) équipement spécialement conçu pour la fabrication ou l'essai de tubes électroniques, d'éléments optiques et de leurs composants spécialement conçus, inclus dans les articles 1541, 1542, 1555, 1556, 1558 ou 1559;
- b) équipement spécialement conçu pour la fabrication ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'ensembles et systèmes comprenant cet équipement ou présentant les caractéristiques de cet équipement, à savoir:
 - (i) équipement, à l'exclusion des creusets en quartz spécialement conçus pour le traitement de matériaux en vue de la fabrication des dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'ensembles, à savoir:
 - (A) équipement pour la production de silicium polycristallin, inclus dans l'alinéa 1757f), d'une pureté égale ou supérieure à 99,99 pour cent, sous forme de baguettes, lingots, boules, billes, feuilles, tubes ou petites particules,
 - (B) équipement spécialement conçu pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V et II-VI inclus dans l'article 1757,
 - (C) appareils de tirage des cristaux, fours à cristaux et systèmes à gaz, à savoir: